

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2024年2月1日(01.02.2024)



(10) 国際公開番号

WO 2024/024807 A1

(51) 国際特許分類:
H01L 21/68 (2006.01) H01L 21/677 (2006.01)
H01L 21/50 (2006.01) H05K 13/02 (2006.01)
H01L 21/67 (2006.01) H05K 13/04 (2006.01)

(21) 国際出願番号: PCT/JP2023/027283

(22) 国際出願日: 2023年7月25日(25.07.2023)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願 2022-119662 2022年7月27日(27.07.2022) JP
特願 2022-169188 2022年10月21日(21.10.2022) JP

(71) 出願人: 上野精機株式会社 (UENO SEIKI CO., LTD.) [JP/JP]; 〒8070052 福岡県遠賀郡水巻町下二西一丁目2番18号 Fukuoka (JP).

(72) 発明者: 南 日出夫 (MINAMI Hideo); 〒8070052 福岡県遠賀郡水巻町下二西一丁目2番18号 上野精機株式会社内 Fukuoka (JP). 上田 陵司 (UEDA Ryoji); 〒8070052 福岡県遠賀

郡水巻町下二西一丁目2番18号 上野精機株式会社内 Fukuoka (JP).

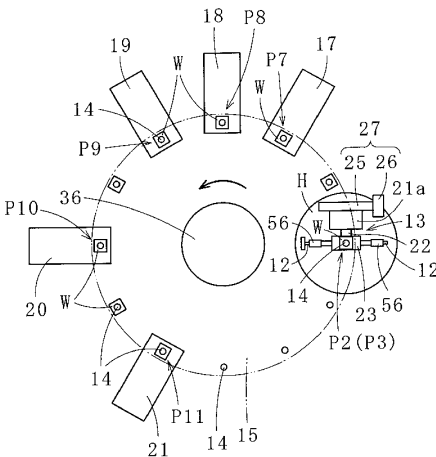
(74) 代理人: 弁理士法人栄光事務所 (EIKOH, P.C.); 〒1050003 東京都港区西新橋一丁目7番13号 虎ノ門イーストビルディング10階 Tokyo (JP).

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(54) Title: ELECTRONIC COMPONENT PROCESSING DEVICE

(54) 発明の名称: 電子部品処理装置

<2>



(57) Abstract: An electronic component processing device (10) comprises: an ejector mechanism that ejects an electronic component (W) attached to a wafer sheet; a pick-up unit (13) having a component support part (12) that acquires the ejected electronic component (W); a transfer unit that transfers, by rotation of a rotating body (15) to which a component holding unit (14) that acquires the electronic component (W) from the pick-up unit (13) has been attached, the component holding part (14) to a processing position (P7-P11); and processing units (17-21) that perform prescribed processing on the electronic component (W).

(57) 要約: 電子部品処理装置 (10) は、ウエハシートに貼付された電子部品 (W) を突き出す突出機構と、突き出された電子部品 (W) を取得する部品支持部 (12) を有するピックアップユニット (13) と、ピックアップユニット (13) から電子部品 (W) を取得する部品保持部 (14) が取り付けられた回転体 (15) の回転により部品保持部 (14) が処理位置 (P7~P11) まで移動する搬送ユニットと、電子部品 (W) に所定の処理を行う処理ユニット (17~21) と、を備える。

WO 2024/024807 A1

[続葉有]

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告 (条約第21条(3))